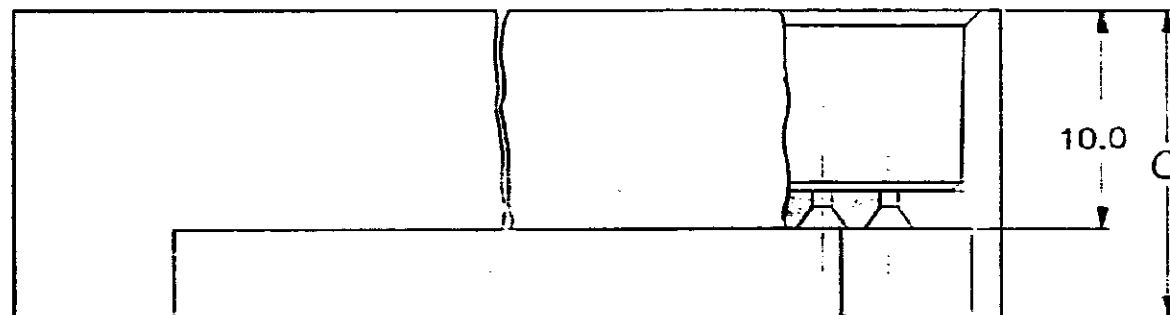


SECT. "A"-A"



SECT. "B"-B"

注記

1. 材料 樹脂 ガラス入 PBT UL 94V-0, 黒
2. 製品規格 108-5197
3. 本フードはリセプタクル・アセンブリを基板に取り付け後、ポスト側に取付け、次のリセプタクル・アセンブリと嵌合させる。  
△ 0.60 DIA は 両側 16 ホール (片側 8 ホール) のみ適用。FEI 階 3-8 は除く。

NOTES:

1. HSG MATERIAL; PBT (GLASS), UL 94V-0, BLK.
  2. PRODUCT SPEC; 108-5197
  3. THIS HSG SHALL BE ASSEMBLED WITH POST CONTACT OF REC ASSY AFTER INSERTED ONTO P.C BOARD.
- △ 0.60 DIA APPLY TO 16 HOLES ON BOTH SIDES, EXCEPT PN 3-8.
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE	↑	48.26	55.9	19	40	3	8
		40.64	48.3	16	34	1-	-4
		30.48	38.1	12	26	1-	-3
		73.66	81.3	29	60	1-	-0
		65.26	68.6	24	50		-9
		48.26	55.9	19	40		-8
		15.6	33.56	43.2	14	30	-7
△ OBSOLETE	↑	40.64	48.3	16	34	+	-2
△ OBSOLETE	↑	30.48	38.1	12	26	+	-1
		73.66	81.3	29	60		-5
		65.96	68.6	24	50		-4
		48.26	55.9	19	40		-3
		10.0	33.56	43.2	14	30	173144 -2

PST NO. 251-163

DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

C1: ECO-10-000444	KK AEG JAN10
C: 追加 J-1002 T.F. KS	9-27
B: 修正 2592 KS	8-4
A: 追加 8105 KS	3-10
O: 作成 2002 KS	3-10
LTR: 2R (REVISION RECORD)	DR: CHK (DATE)

© 1984年 株式会社 AMP		© 1984年 AMP Japan LTD.		AMP		東京エレクトロニクス株式会社 TOKYO, JAPAN	
AMP-1133 LITERATURE DEPT.		ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING					
WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME: ポスト・フード POST HOOD HSG					
AWG	mm	MATERIAL: スチール					
		FINISH: ±0.25					
DR: KS 12-17-84 DE		CHK: KS 12-17-84		SIZE LOC # (NO): C J 173144		SCALE: REV: C1 SHEET: 1 OF 1	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-173144-0](#)